

ДИФФУЗИОННОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ ПЛЕНОК $a\text{-Si : H}$ ПРИМЕСЯМИ Sn, Ag, Fe И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Аблова М. С., Куликов Г. С., Першев С. К., Ходжаев К. Х.

На основе изучения в интервале температур 290—525 °C диффузии и растворимости примесей олова, железа и серебра в пленках аморфного гидрогенизированного кремния ($a\text{-Si : H}$) определен режим диффузационного легирования, получены диффузионно легированные этими металлами пленки $a\text{-Si : H}$ и исследована их темновая и фотопроводимость. Диффузионное легирование металлами приводит к появлению больших энергий активации электропроводности (до 1.4 эВ, т. е. $E_A > E_{hv}^0/2$), не типичных для собственного материала. Циклический нагрев легированных пленок в интервале температур 20—200 °C приводит к постепенному возвращению их электрических свойств к свойствам исходного $a\text{-Si : H}$, что подобно явлению распада пересыщенного твердого раствора в кристаллах.

В процессе изготовления и эксплуатации приборов на основе аморфного гидрогенизированного кремния $a\text{-Si : H}$ (солнечных преобразователей, фотодиодов, $p-i-n$ -диодов, тонкопленочных полевых транзисторов и т. д.) примеси элементов, входящие в состав контактов и контактных слоев, могут диффундировать в слой $a\text{-Si : H}$, приводя к изменению параметров прибора. В частности, одной из проблем, возникающих при изготовлении приборов со структурой «стекло—слой ITO—(p^-i-n^+ —металл)», является диффузия входящих в состав ITO примесей индия и олова, приводящая к деградации $p^+ - i$ -перехода [1, 2]. Внимание с этой точки зрения заслуживают также примеси серебра и железа, первое из которых используется для создания отражающего контактного слоя, а второе применяется в качестве материала подложки. Однако целенаправленных исследований влияния примесей, вводимых в слой $a\text{-Si : H}$ диффузионным легированием, на электрофизические свойства материала, за исключением работ по введению в $a\text{-Si}$ и $a\text{-Si : H}$ примеси лития [3—5], насколько нам известно, не проводилось.

Цель настоящей работы — определение режима диффузионного насыщения пленок $a\text{-Si : H}$ примесями Sn, Ag, Fe и исследование влияния диффузионно введенных примесей на темновую и фотопроводимость такого материала.

Пленки $a\text{-Si : H}$ толщиной 0.9 мкм были получены разложением моносилана в плазме ВЧ разряда при температуре подложки (кварца или монокристаллического кремния) 290 °C. Содержание водорода в пленках, по данным ИК поглощения, составляло ~13 ат%. Для определения режима диффузионного насыщения были измерены коэффициенты диффузии и растворимость указанных примесей в пленках собственного материала $a\text{-Si : H}$, поскольку такие данные известны только для $c\text{-Si}$ [6—9], а также для $a\text{-Si : H}$, легированного фосфором [10]. Диффузия примесей осуществлялась в интервале температур 290—525 °C из слоя радиоактивного изотопа ^{119m}Sn , ^{110m}Ag , ^{59}Fe , напыленного на поверхность пленки. Концентрационные профили примесей, по которым вычислялись коэффициенты диффузии, определялись послойным анализом остаточной радиоактивности пленки [11]. За величину растворимости принимался равномерный по толщине пленки максимальный уровень насыщения примесью. На рис. 1 приведены полученные нами температурные зависимости растворимости олова, серебра и железа в пленках $a\text{-Si : H}$. В отличие от олова и железа

растворимость серебра носит ретроградный характер с максимумом при 400°C . По этой и другим причинам эта температура была выбрана в качестве оптимальной для диффузационного насыщения металлами пленок $a\text{-Si : H}$. Время насыщенной для диффузионного насыщения металлами пленок $a\text{-Si : H}$.

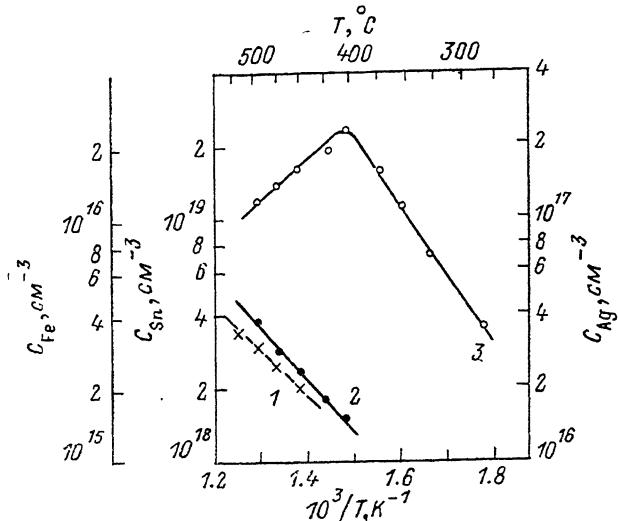


Рис. 1. Температурная зависимость растворимости серебра, олова и железа в пленках $a\text{-Si : H}$, диффузионно насыщенных этими примесями.

1 — Fe, 2 — Sn, 3 — Ag.

ния определялось с учетом коэффициентов диффузии и растворимости данного металла. Оно составляло для серебра и железа 40 мин, для олова 14 ч (с учетом быстрой и медленной диффузионных компонент серебра и железа). Это соответствовало введенным в пленки и проконтролированным методом меченым атомов концентрациям металла: $N_{\text{Ag}} = 2.4 \times 10^{17}$, $N_{\text{Sn}} = 1.4 \cdot 10^{18}$, $N_{\text{Fe}} = 1.3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$.

Далее на таких диффузионно легированных нерадиоактивными металлами пленках, а также на исходной и контрольных нелегированных пленках, отожженных при температурах и временах, соответствующих таковым при диффузии

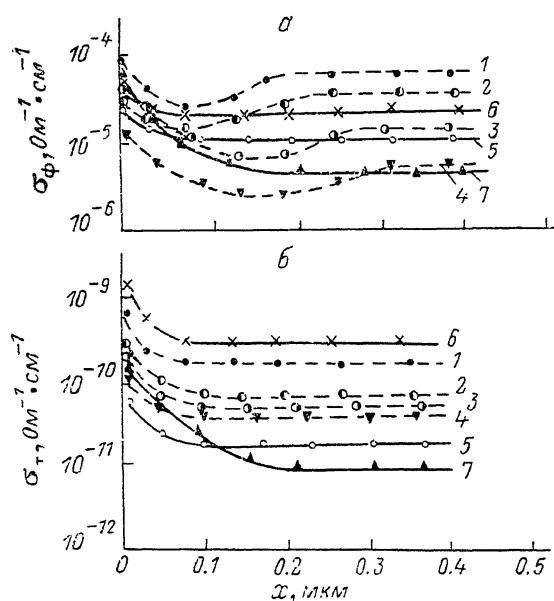


Рис. 2. Изменение распределения фотопроводимости (а) и темновой проводимости (б) по толщине пленки $a\text{-Si : H}$ в результате отжига (2—4) и диффузионного насыщения примесью (5—7) при 400°C .

Время отжига, мин: 2 — 10, 3 — 40, 4 — $8.4 \cdot 10^2$. Легирующие металлы: 5 — Sn, 6 — Ag_3 , 7 — Fe. Кривые 1 — для исходных неотожженных пленок.

онном легировании, проводились измерения распределения темновой и фотопроводимости по толщине пленки (рис. 2, а, б). Сравнение значений темновой и фотопроводимости легированных (кривые 5—7) и контрольных (кривые 2—4) пленок свидетельствует о проявлении легирующего эффекта, большего для примесей железа, серебра и меньшего для олова. Эффект донорного характера проявляется в увеличении электропроводности пленок $a\text{-Si : H}$, легированных серебром, а эффект акцепторного характера (компенсирующий) — в уменьшении электропроводности пленок, легированных железом или оловом.

Качественно наблюдаемый легирующий эффект указанных примесей в $a\text{-Si : H}$ согласуется с их поведением в $c\text{-Si}$ [8–12]. Аналогичный характер поведения проявляют олово и железо в пленках $a\text{-Si : H}$, легированных этими примесями в процессе выращивания [13–17]. Отметим, что акцепторный характер поведения олова в $a\text{-Si : H}$ может быть связан с образованием комплексов SnO_2 и SnO_4 . Такие комплексы были обнаружены с помощью мессбауэровской спектроскопии в наших пленках, легированных оловом.¹

Укажем также на то, что легирование пленок $a\text{-Si : H}$ примесями металлов улучшает однородность распределения электропроводности по их толщине

Рис. 3. Температурная зависимость электропроводности пленок $a\text{-Si : H}$, диффузионно легированных серебром, оловом и железом.

Образцы: *a* — контрольный, *b*, *e*, *g* — легированные оловом, серебром, железом соответственно. Цифры у кривых — значения энергии активации (в эВ).

(рис. 2, *a*, кривые 2—4 и 5—7). Это может быть объяснено залечиванием металлами некоторых дефектов, присутствующих в исходной и контрольных пленках

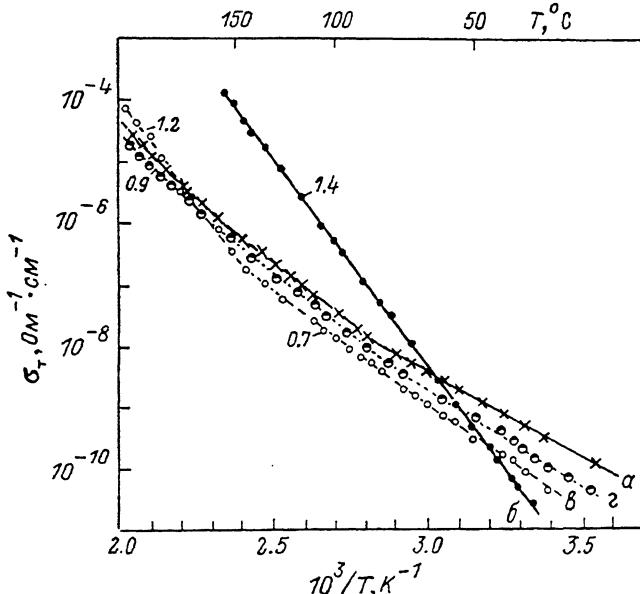
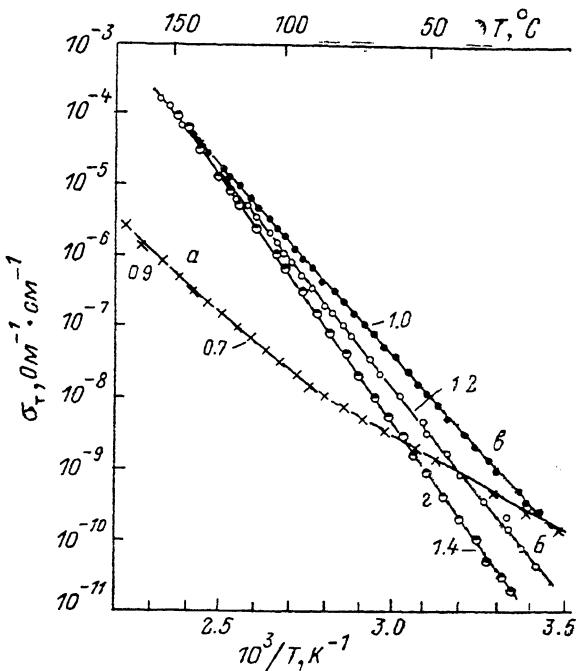


Рис. 4. Изменение характера температурной зависимости электропроводности пленки $a\text{-Si : H}$, диффузионно насыщенной железом, в результате циклического нагрева 20–200 °С. Образцы: *a* — контрольный, *b*, *e*, *g* — диффузионно легированный после первого, второго и третьего нагрева соответственно. Цифры у кривых — значения энергии активации (в эВ).

и обусловливающих неоднородность распределения фотопроводимости по толщине, связанную отчасти с обедненностью водородом приповерхностной и пере-

¹ Данные получены Ф. С. Насрединовым.

ходной (пленка—подложка) областей пленки вследствие экзоэффекта водорода [10].

С целью получения более полной информации о свойствах пленок, диффузионно насыщенных металлами, была исследована также температурная зависимость темновой проводимости пленок. На рис. 3 такая зависимость $\lg \sigma_t = f(1/T)$ приведена для контрольной пленки из собственного $a\text{-Si : H}$, отожженной 14 ч при 400 °C, и трех пленок, диффузионно насыщенных одним из металлов. Для собственного $a\text{-Si : H}$ наблюдаются обычные для него величины электропроводности $\sim 10^{-10} \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при комнатной температуре и типичные для собственного материала энергии активации $E_a = 0.9$ и 0.7 эВ [18], а также иногда появляющиеся меньшие значения энергии активации [18, 19]. Кривые $\lg \sigma_t = f(1/T)$ для пленок, легированных металлами, сходны между собой и существенно отличаются от кривой для контрольного образца, в частности, большими энергиями активации. Это — особый случай, когда $E_a > E_g^h / 2$ (для наших пленок $E_g^h = 1.86$ эВ). При этом, по-видимому, состояние аморфной матрицы с введенным в нее металлом является неустойчивым, так как нагрев таких легированных пленок до ~ 200 °C приводит к изменению характера температурной зависимости электропроводности. Это проявляется в трансформации первоначальной кривой $\lg \sigma_t = f(1/T)$ с большой и единой в исследованном температурном интервале энергией активации в кривую с двумя или тремя меньшими значениями энергии активации [см. рис. 4, где в качестве примера такое изменение кривой $\lg \sigma_t = f(1/T)$ приведено для пленки, легированной железом]. Детально кинетика такого переходного процесса нами не изучалась. Заметим лишь, что после циклического нагрева электрические свойства легированных пленок становились близкими к исходным. Быстрее всего этот процесс происходил в пленках, легированных железом. При этом отношение фотопроводимости к темновой σ_{ph}/σ_t по-прежнему составляло величину $10^5 - 10^6$, т. е. фотоэлектрические свойства не ухудшились.

Мы полагаем, что наблюдаемое явление обусловлено процессами, подобными процессу распада пересыщенного кристаллического раствора. При нагреве металлические примеси в аморфной матрице могут высаживаться на внутренних поверхностях, в микропорах, межстолбовых промежутках и т. д., а остальная часть аморфной матрицы очищается от них, за счет чего восстанавливаются исходные свойства. Такое явление в $a\text{-Si : H}$, насколько нам известно, ранее не наблюдалось, однако у него есть аналог в монокристаллическом кремнии. Так, в работах [6, 12] исследовался распад твердого раствора в образцах $c\text{-Si}$, диффузионно легированных примесью железа. При этом в процессе распада наблюдалось изменение электрических свойств легированных образцов, обусловленное уходом электрически активных атомов железа на центры распада (дислокации и т. п.), в результате чего электрические свойства $c\text{-Si}$ восстанавливались до исходных, характерных для нелегированного материала.

Список литературы

- [1] Mäenpää M., Suni J., Sigurd D., Finetti M., Nicolet M. A. // Phys. St. Sol. (a). 1982. V. 72. N 2. P. 763—769.
- [2] Madan A., McMahon T. J. // Sol. Cells. 1985. V. 13. N 3. P. 265—269.
- [3] Winer K., Street R. A. // J. Appl. Phys. 1989. V. 65. N 6. P. 2272—2281.
- [4] Beyer W., Fischer R. A., Wagner H. // J. Electron. Mater. 1979. V. 8. N 2. P. 127—137.
- [5] Beyer W. // Sol. St. Commun. 1979. V. 29. P. 291—294.
- [6] Болтакс Б. И., Бахадырханов М. К., Куликов Г. С. // ФТП. 1974. Т. 13. В. 9. С. 2675—2678.
- [7] Struthers J. D. // J. Appl. Phys. 1956. V. 27. N 12. P. 1560—1561.
- [8] Болтакс Б. И., Сюэ Ши-инь // ФТП. 1960. Т. 2. В. 11. С. 2677—2684.
- [9] Yeh T. H., Hu S. M., Kostl R. H. // J. Appl. Phys. 1968. V. 30. N 9. P. 4266—4271.
- [10] Kudojarova V. Kh., Kulikov G. S., Khodzhaev K. Kh. // Proc. 5 Int. School Cond. Matter Physics. Varna, Bulgaria, 1988. Р. 640—659.
- [11] Аброва М. С., Абдурахманов К. П., Абдумапапов У. Ж., Куликов Г. С., Уткин-Эдип Д. П., Ходжаев К. Х. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 1. С. 20—23.
- [12] Есндиқ Н. Т., Мильевский Л. С., Гарник В. С. // ФТП. 1970. Т. 12. В. 10. С. 1693—1701.
- [13] Андреев А. А., Голикова О. А., Насрединов Ф. С., Ництирюк П. А., Серегин П. П. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 6. С. 1117—1119.
- [14] Von Reudern B., Mahan A. H., Köhenkamp R., Williamson D. L., Sanchez A., Madan A. // J. Non-Cryst. Sol. 1984. V. 66. N 1. P. 13—20.

- [15] Сидорова Т. А., Голикова О. А., Андреев А. А., Гуц З. А., Аблова М. С., Фейгельман В. А., Виноградов В. Я. // Изв. АН СССР. Неорг. матер. 1984. Т. 20. В. 7. С. 1077—1080.
- [16] Голикова О. А., Мездргина М. М., Кудоярова В. Х., Серегин П. П. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 8. С. 1464—1466.
- [17] Регель А. Р., Серегин П. П., Мездргина М. М., Насрединов Ф. С., Аблова М. С., Абдуманапов У. Ж. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 1. С. 161—164.
- [18] Андреев А. А., Сидорова Т. А., Казакова Е. А., Аблова М. С., Виноградов В. Я. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 8. С. 1469—1475.
- [19] Андреев А. А., Аблова М. С., Сидорова Т. А., Казакова Е. А., Пилатов А. Г., Тургунов Т. Т. // Изв. АН СССР. Неорг. матер. 1989. Т. 25. В. 6. С. 900—904.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получена 18.06.1990
Принята к печати 21.06.1990